

近年の電子回路は消費電力や周波数が高くなっており
プリント配線板上でただ接続するだけでは問題が発生する可能性があります

シミュレーションツール

- ・ Fujitsu Signal Adviser SI
- ・ ANSYS SIwave
- ・ ANSYS HFSS
- ・ NEC DEMITASNX
- ・ CADENCE Power SI
- ・ CADENCE Power DC
- ・ CADENCE SPEED2000
- ・ Murata Femtet

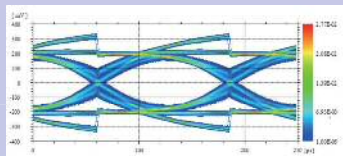
近年対応実績

SoC, FPGA	i.MX6/7/8 (NXP) Zynq, Kintex (Xilinx) Arria10 (Intel) 等
メモリー-I/F	DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR4/GDDR5等
高速通信	FPD-LINK (PoC), CoaXpress, PCIeGen2/3 12G-SDI 等

信号系解析

配線形態や部品定数を最適化し
信号の劣化等による不具合を防ぎます。

- | | |
|----------|--------------|
| アウトプット例 | 近年の解析事例 |
| ・ 信号波形 | ・ DDR4 |
| ・ Sパラメータ | ・ LPDDR4 |
| ・ TDR特性 | ・ JESD204B |
| | ・ 12G-SDI など |



電源系解析

プリント配線板の寄生成分等により、意図した電源性能を
保てないケースが増えています。
電圧変動や電圧降下によるICの誤動作を防ぎます。

IRドロップ
(電圧降下対策)



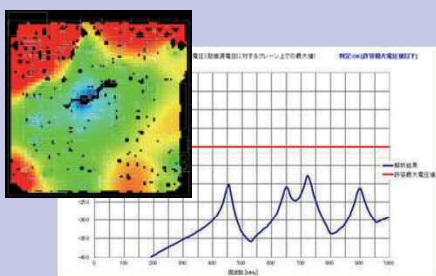
インプットインピーダンス
(電圧変動対策)



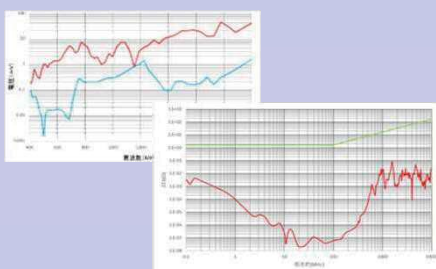
ノイズ系解析

様々な観点からノイズ低減のアプローチを行います。

プレーン共振解析



各パラメータによる評価



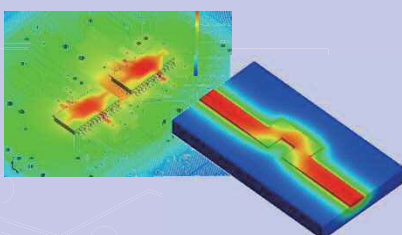
遠方・近傍界解析



熱解析

適切な放熱経路を確保し
プリント配線板全体の
放熱性能を向上させます。

- ・ 部品による発熱
- ・ 銅箔によるジュール発熱



プリント配線板メーカーならではの
基板構成提案。

工場直結の基板スペック確認。

低コストへのアプローチ。

電気特性、量産性を踏まえた
設計思想を提供いたします。

